

新世代パッケージング分科会

本分科会のポイント

- 産総研「新世代ハイブリッドパッケージ開発拠点」活用に向けた
- 国内外の関連研究者を招き、講演、意見交換を実施。
- 関連国際学会から最新の研究開発動向を分析。

本分科会のねらい

- 半導体後工程・フレキシブル機材・印刷・配線・実装分野の技術開発動向を調査・共有し、課題の抽出、技術的解決策の議論を重ね、参加メンバーの開発競争力強化とメンバー間の連携強化を図る。
- 参加メンバー間での新たな連携プロジェクトの創出、公的支援資金の獲得、事業化を目指した活動を行う。

活 動 内 容

- 国内外の専門家を招き、講演・意見交換を通じて、半導体後工程・フレキシブル機材・印刷・配線・実装分野の技術開発動向を調査。
- 関連国際学会から最新の研究開発動向を分析する研究会を実施。
- (IEEE MEMS@1月、ISSCC@2月、ICEP@4月、ECTC@5月、VLSI@6月、IEDM@12月、など)
- 個別の共同研究の実施に向けた協議、公的研究資金の獲得に向けた共同提案。産総研つくば東地区に新設される「新世代ハイブリッドパッケージ開発拠点」の活用。



センシングシステム研究センター

竹井裕介 (yusuke-takei@aist.go.jp)、岡田浩尚 (hironao.okada@aist.go.jp)
 岡本有貴 (yuki.okamoto@aist.go.jp)、森田伸友 (morita.nobutomo@aist.go.jp)

国立研究開発法人
産業技術総合研究所